Subject: 796

Date: 2011年9月19日

TO: プリント基板（ZPMV2、ZPMV3、ZPMV8、ZPMV9）のULコンポーネント・レコグニション・サービスのお客様

SUBJECT: プリント配線板（ZPMV2、ZPMV3、ZPMV8、ZPMV9）の共通アペンディクスページ（SAP）の改訂版発行について

ULは、プリント基板（ZPMV2、ZPMV3、ZPMV8、ZPMV9）の共通アペンディクスページ（SAP）の改訂版を発行致しました。

改訂内容には、製造者及びUL検査員への指示を明確にするための更新及び修正が含まれます。ULでのフォローアップ試験用のサンプル抜き取りが、一貫したサンプルグループ分け基準（基板のANSI又はジェネリックタイプに基づく）及びサンプル抜き取り頻度を指定するよう修正されました。これらの改訂は、現行の抜き取りに関する要求事項を簡略化し、さらに、要求事項のより一貫した適用を保証するのに役立ちます。今回の改訂によって、ほとんどの場合、ULでの試験のために抜き取られる基板数を大幅に増やす予定はありませんが、頻度については多少の調整が行われる可能性があり、いずれの場合もケースバイケースの状況に基づいて判断されます。アペンディクス Eは、共通アペンディクスページ（SAP）を通して、又は検査中に使用される一般用語の定義を追記するために追加されました。

今後「レコグナイズドされていない」材料は、サンプル抜き取りに関するアペンディクス・ページには記載されないことになり、これまで記載されていたものは、アンリスティッド・コンポーネントのQMTS3又はQMJU3ファイルボリュームへと移動されたか、これから移動されることになり、それらは該当するカテゴリーのサンプル抜き取り基準の対象となります。さらに、これらの「レコグナイズドされていない」材料の移動は無償で実施され、移動によって検査費用の増分が発生することはありません。（補足：ファイルの年間維持費用の増分も発生しません。）

改訂された製造者毎のサンプル抜き取り及び試験情報ページ、及び本ブリテンに概説される変更点を記載した改訂共通アペンディクスページ（SAP）は、別途2012年1月31日までに発行される予定です。製造者は、2011年9月19日付けの改訂共通アペンディクスページ（SAP）を受理するまでは、引き続き本ブリテンに記載される情報とともに現行の共通アペンディクスページ（SAP）を使用しなければなりません。

共通アペンディクスページ（SAP）の改訂事項は現行の手順を反映しており、即日発効となります。共通アペンディクスページ（SAP）の改訂版への主な変更点は下記に記載した通りです：

アペンディクスA

- 該当するULマーク・サーベイランス文書を参照し、一般的な共通アペンディクスページ（SAP）テンプレートの言文を取り入れた
- サブコントラクターを使用するための受け入れ試験への参照を削除した
- 基板のパラメーター及び製造工程に関する製品検査に関する指示を更新した
- マルチサイト・プロセッシングに関する指示を更新した
- 燃焼性のみの基板に関する指示を更新した

アペンディクスB

- 一般的な共通事項付属ページ（SAP）テンプレートの言文を取り入れた
- サンプルグループ分け基準及びサンプル抜き取り頻度を再定義することでサンプル抜き取り指示を改訂した
- フォローアップ試験に必要な小型基板(補足:導体パターン長さが、13㎜以上、38㎜未満のもの)の数を12個から6個へと削減した
- レコグナイズドされていない材料は、アンリスティッド・コンポーネントのファイルボリュームの対象となるため、レコグナイズドされていない材料のサンプル抜き取りに関する要求事項及びガイドを削除した

アペンディクスC

- 試験の手順を明確にした
- 同じ情報がスペシャル・アペンディクスBのサンプル・セレクション・ガイドに記載されるため、PWBタイプが56日間の接着強度試験を必要とすることを示す表を削除した。
- アンリスティッド材料はすべてアンリスティッド・コンポーネントのファイルボリュームの対象となるため、赤外線分析（IR）及び関連データを削除した

アペンディクスD

- 該当するULマーク・サーベイランス文書を参照し、一般的なSAPテンプレートの言文を取り入れた
- マルチサイト・プロセッサ及びサブコントラクターの要求事項を説明するよう、マルチサイト・プロセッシングに関する指示を更新した
- マルチサイト・プロセッサ情報を削除した

アペンディクスE

- 用語及び定義をアペンディクスAからこの新アペンディクスへと移動し、規格に指定されるものと整合した

スペシャル・アペンディクスB

- サンプル・セレクション・ガイドに入れるためスペシャル・アペンディクスBを追加し、フットノート・ページにインデックスを追加した

本ブリテン又は改訂共通アペンディクスページ（SAP）ページのファイリングや使用に関して何か質問がありましたら、各担当検査員までお問い合わせください。

上記に関して何かご質問がありましたら、Crystal Vanderpanまでお電話（1+408-754-6584）又はEメール（Crystal.e.Vanderpan@us.ul.com）でご連絡ください。

ULのフォローアップサービス・プログラムへの引き続きのご協力をよろしくお願い致します。

検証者:

Crystal Vanderpan

John Thompson

Crystal Vanderpan
Principal Engineer (PDE)
Printed Circuit Technologies
Phone: 408-754-6584
E-mail: Crystal.e.Vanderpan@us.ul.com

John Thompson
PDE Director
Power, Industrial, Chemicals, Wire & Cable, Energy